



JASDAQ

2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社**フェローテックホールディングス**

代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)

問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ (第二弾)

株式会社フェローテックホールディングス(代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」)は、パワー半導体用基板製造子会社である江蘇富楽徳半導体科技有限公司(以下、「FTSJ」)が、将来的に中国の科创板市場での上場を目指す過程において、更なる事業拡大へ向けて2回目の第三者割当増資を行うことを決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

1. 増資の背景と目的

2020年11月17日付開示「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」の中で、将来的にFTSJを中国のハイテク企業向け市場である科创板市場(スター・マーケット)へ上場させることを前提に、地元政府基金および主要顧客との戦略パートナー関係を構築することが当社グループの企業価値向上に資する観点から第三割当増資を実施する旨お知らせしましたが、本件は、生産能力増強のための二回目の第三者割当増資となります。今回の増資の目的は、前回と同様に、全世界的なパワー半導体市場の成長、および脱炭素社会実現へ向けた機運の高まりを受けた電気自動車の需要拡大などの背景から、FTSJ東台工場(中国・江蘇省)でのパワー半導体用絶縁・放熱基板(DCB基板)、および窒化ケイ素や窒化アルミニウムを基材とした、より放熱性や信頼性の高いAMB(Active Metal Brazing: 活性ロウ付け法)方式の新たな技術による基板の早期の生産能力増強へ向けた設備投資資金の調達の主たる目的となります。

<用語説明> ～ DCB基板とは ～

パワー半導体基板には高い放熱性に加え、回路以外の部分には高い絶縁性が求められることから、放熱性・絶縁性・耐久性が高いアルミナや窒化アルミニウムなどの絶縁体に銅製(Copper)の回路を直接結合(Direct Bonding)させた基板のことをDCB基板といいます。

用途としては、白物家電(特にエアコンのインバータ向け)、ロボット、NC(数値制御)加工機械、サーボ、インバータなどに使われており、さらに自動車のエンジンやモータ、パワーステアリング、ヘッドランプなどの制御装置の基板として採用されているほか、自然エネルギー(風力発電・太陽光発電など)関連装置のモータ制御用インバータとして用いられています。

2. 調達資金の使途

主に設備増強投資、自動化投資、新素材開発投資等へ充当する予定です。詳細が確定次第、改めてお知らせ

します。

3. 子会社の概要

(1) 名 称	江蘇富樂德半導體科技有限公司 (FTSJ)		
(2) 所 在 地	中華人民共和國江蘇省東台市城東新区鴻達路18号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢		
(4) 事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売		
(5) 資 本 金	225,598千人民元 (約36.0億円) 2020年11月25日現在 ※1人民元=16.00円		
(6) 設 立 年 月 日	2018年3月16日		
(7) 大株主及び持分比率	株主名	現状	本件後
	上海申和熱磁電子有限公司 (FTS)	88.89%	74.08%
	FTSJ役職員持株会	8.89%	7.41%
	上海臨芯投資管理有限公司		6.67%
	上海興橙投資管理有限公司		6.67%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社であるFTSが議決権の88.89%を保有する子会社です。	
	人 的 関 係	当社の取締役1名が当該子会社の董事を兼任。	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	
(9) 最近1ヵ年の経営成績及び財政状態 (単位未満切り捨て)			
決 算 期	2019年12月期		
純 資 産	129,392千人民元 (2,070百万円)		
総 資 産	345,077千人民元 (5,521百万円)		
1株あたり純資産	— (—百万円)		
売 上 高	99,277千人民元 (1,588百万円)		
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△2,618千人民元 (△41百万円)		
1株あたり配当金	— (—百万円)		

(注1) 円換算レート 1人民元=16.00円

(注2) 1株あたりの純資産は、当該子会社が有限公司の為、記載につき省略しております。

(注3) 2018年12月期(設立期)は未稼働である為、経営成績及び財政状態は2019年12月期のみを記載しております。

4. 第三者割当の概要

(1) 発 行 価 額	資本金1人民元あたり4.477人民元 (約71.63円) ※1人民元=16.00円
(2) 払 込 出 資 金 総 額	202,000千人民元 (約32.3億円)
(3) 払 込 期 日	2021年2月25日

(4) 増加資本金	45,089千人民元(約7.2億円)	
(5) 増資後登録資本金	270,687千人民元(約43.3億円)	
(6) 割当後の持分比率	① 上海臨芯投資管理有限公司	6.66%
	② 上海興橙投資管理有限公司	6.66%
	③ 嘉興紅晔第一期半導體産業持分投資パートナー企業	1.67%
	④ 上海自貿区股權投資基金管理有限公司	0.83%
	⑤ 上海浦東科技投資有限公司	0.83%

(注)当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当先の概要

	①	②
(1) 社名	上海臨芯投資管理有限公司	上海興橙投資管理有限公司
(2) 資本金	30百万人民元(約4.8億円)	10百万人民元(約1.6億円)
(3) 設立年月日	2015年5月26日	2014年12月23日
(4) 大株主及び持分比率	確認中	確認中
(5) 代表者	李亜軍	陳曉飛
(6) 事業内容	実業投資、投資コンサルティング	実業投資、投資コンサルティング
(7) 上場会社と当該会社との関係	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額及び持分比率	18.0百万人民元(約2.88億円) 6.66%	18.0百万人民元(約2.88億円) 6.66%

	③	④
(1) 社名	嘉興紅晔第一期半導體産業持分投資パートナー企業	上海自貿区股權投資基金管理有限公司
(2) 資本金	確認中	33.6百万人民元(約5.3億円)
(3) 設立年月日	2015年5月26日	2015年2月28日
(4) 大株主及び持分比率	GP(無限責任):上海普凱天吉投資管理有限公司 50%、LP1(有限責任):許雷 50%	上海陸家嘴金融發展有限公司 14.28%
(5) 代表者	確認中	吳劍平(董事長)
(6) 事業内容	実業投資、投資コンサルティング	実業投資、資産経営、国内貿易、財務コンサルティングなど。
(7) 上場会社と当該会社との関係	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額及び持分比率	4.5百万人民元(約0.72億円) 1.67%	2,2百万人民元(約0.35億円) 0.83%

		⑤
(1)	社名	上海浦東科技投資有限公司
(2)	資本金	30億人民幣元(約480.0億円)
(3)	設立年月日	1999年6月30日
(4)	大株主及び持ち分比率	上海宏天元創業投資パートナー企業(有限パートナー) 51%、上海上実資産経営有限公司25%、上海浦東投資ホールディングス(グループ) 24%
(5)	代表者	朱旭东(代表取締役)
(6)	事業内容	創業投資、実業投資、投資管理、投資コンサルティング、企業管理コンサルティング、企業合併再構成のコンサルティング、財務コンサルティング、資産管理。
(7)	上場会社と当該会社との関係	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。
(8)	出資金額及び持ち分比率	2.2百万人民幣元(約0.35億円) 0.83%

(注1) 1人民幣元=16.00円

(注2) 割当先については、現在調整中であり変更になる可能性もございます。訂正が生じた場合は速やかに開示させていただきます。

6. 支配株主との取引に関する事項

該当しません。

7. 払込の期日

2021年2月25日(木)

8. 今後の見通し

連結業績への影響につきましては現在精査中ではありますが、必要と判断された場合には、速やかにお知らせいたします。

以上